

浙江众合科技股份有限公司关于控股子公司 海纳股份加大力度投资升级高端功率器件用半导体 级抛光片生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）历史审议与披露情况

1、2023年5月5日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）总裁办公会议审议通过了浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“海纳股份”）《关于控股子公司海纳股份对外投资建设高端功率器件用半导体级抛光片生产线的议案》，同意海纳股份投资建设高附加值工艺的高端功率器件用半导体级抛光片生产线，实现年产约260万片4-6英寸抛光片；授权海纳股份经营管理层在浙江省内根据不同地域优惠政策进行项目公司最终选址，并聘请第三方机构进行可行性研究报告的编制；同时，授权与政府方进行入园协议条款的协商和签订、办理项目落地注册的相关行政审批手续；

2、2023年6月8日，海纳股份与浙江省浦江经济开发区管理委员会签署了《半导体级抛光片生产线项目投资框架协议》，就海纳股份在浦江县投资建设半导体级抛光片生产线项目的相关事宜达成一致，项目计划总投资约20亿元。具体内容详见公司2023年6月12日发布于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司海纳股份与浙江省浦江经济开发区管理委员会签署〈半导体级抛光片生产线项目投资框架协议〉的公告》（公告编号：临2023-062）。

（二）对外投资进展情况

随着项目前期筹建工作不断深入，厂房设计、设备选型等工作不断细化，为遵循国家政策导向并贴合行业未来发展趋势，丰富项目产品种类，升级项目产品规格，海纳股份拟加大投资力度：

1、项目总投资由约20亿元增加至不超过22.14亿元，其中经审议的投资权限由不超过5亿元增加至不超过22.14亿元，并授权经营管理层在该投资额度

内，根据项目建设进度与实际资金需求，分批投入相关资金；

2、海纳股份自有出资额度由不超过 1.5 亿元增加至不超过 2 亿元；

3、项目建设内容由建设年产 260 万枚 4-6 英寸高端功率器件用半导体级抛光片生产线升级为建设年产 432 万片 6-8 英寸抛光片生产线。

截至本公告披露日，本项目对外投资额度未超过原经审议的投资额度。

（三）本次对外投资审议情况

1、公司于 2023 年 12 月 6 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于控股子公司海纳股份加大力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况

2023 年 6 月 13 日，海纳股份完成项目建设主体海纳半导体（金华）有限公司的工商设立手续。海纳半导体（金华）有限公司基本信息如下：

1、公司名称：海纳半导体（金华）有限公司

2、统一社会信用代码：91330726MACM2MLG47

3、成立日期：2023-06-13

4、注册资本：15,000 万人民币

5、注册地址：浙江省金华市浦江县仙华街道一点红大道 966 号 A 幢 6 层

6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；（水晶玻璃制品制造除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：公司为众合科技控股子公司海纳股份全资子公司

三、项目基本情况

1、项目名称：高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目

2、项目建设及运营主体：海纳半导体（金华）有限公司

3、建设地点：浙江省金华市浦江县浦江经济开发区

4、项目用地面积：74,157.13m²，约合 111.23 亩

5、项目总投资：不超过 221,400 万元，其中建设投资为 217,700 万元，铺底流动资金为 3,700 万元。其中，自有资金 20,000 万元，银行贷款 86,800 万元，政府代建 114,600 万元，政府代建部分未来由海纳股份进行回购，即：2025 年—2029 年为租赁期；2030 年起分 5 年回购，可提前回购。该投资将根据生产安排逐步进行，具体将在授权投资额范围内执行。

6、生产规模：年产 432 万片 6-8 英寸抛光片生产线

7、建设内容：厂房建设、生产设施、辅助动力设施、化学品和气体供应设施、环保设施、安全设施、消防设施配置等。新建建筑包括生产厂房、动力站、甲类库、宿舍、门卫 1、门卫 2 等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对外投资符合半导体行业发展的趋势，符合公司“1+2+N”战略规划，有利于公司泛半导体业务的长远发展，有利于优化公司产品结构，有利于进一步拓展细分领域市场，提高公司核心竞争力。

（二）存在的风险

本次对外投资项目建设周期长，投资金额较大，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善内控机制和项目管理体系，统筹规划资金安排，保障项目健康、稳定发展。

本次对外投资项目资金来源包括自筹和融资，存在一定的融资风险。公司将建立健全财务管理和资金管理制度，审慎管控融资信用风险，保障项目资金投入稳定有序。

（三）对公司的影响

本次对外投资旨在巩固发展公司泛半导体业务，加大力度投资建设高附加值生产线，高端产品的研发、生产与未来销售将有利于公司提高市场竞争力，有利于公司长期稳定发展。本次投资符合公司业务发展的需要，资金来源为公司自有资金和融资，并将根据实际业务开展的需要逐步投入，短期内不会影响公司原有日

常经营业务的正常开展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月六日